

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2012 年 12 月 13 日(13.12.2012)



(10) 国際公開番号

WO 2012/169387 A1

- (51) 国際特許分類:  
B65D 73/02 (2006.01) B65D 65/40 (2006.01)  
B32B 27/00 (2006.01) B65D 85/86 (2006.01)  
B32B 27/32 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/063766
- (22) 国際出願日: 2012 年 5 月 29 日(29.05.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2011-127953 2011 年 6 月 8 日(08.06.2011) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 電気化学工業株式会社(DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 佐々木 彰 (SASAKI Akira) [JP/JP]; 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP). 徳永 久次(TOKUNAGA Hisatsugu) [JP/JP]; 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP). 藤村 徹夫 (FUJIMURA Tetsuo) [JP/JP]; 〒3720855 群馬県伊勢

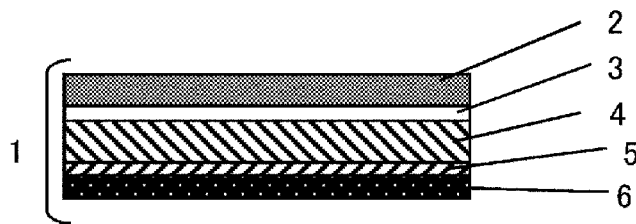
崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP).

- (74) 代理人: 園田 吉隆, 外(SONODA Yoshitaka et al.); 〒1630434 東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号 新宿三井ビル 3 4 階 園田・小林特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

- (54) Title: COVER FILM
- (54) 発明の名称: カバーフィルム

【図1】



(57) Abstract: Disclosed is a cover film and an electronic component package that uses the cover film as a lid material for a thermoplastic resin carrier tape, the cover film having at least a substrate layer (A), an intermediate layer (B), and a heat sealing layer (C) having a thermoplastic resin which can be heat-sealed to a carrier tape, the intermediate layer (B) including a metallocene straight-chain low density polyethylene, the metallocene straight-chain low density polyethylene having a TMA softening temperature of 98 to 109 °C according to JIS K7196, and the cover film in some instances having a release layer (D) between the intermediate layer (B) and the heat sealing layer (C).

(57) 要約: 少なくとも基材層 (A)、中間層 (B)、およびキャリアテープにヒートシール可能な熱可塑性樹脂を有するヒートシール層 (C) を有し、中間層 (B) がメタロセン直鎖状低密度ポリエチレンを含み、該メタロセン直鎖状低密度ポリエチレンの J I S K 7 1 9 6 による TMA 法の軟化温度が 9 8 ~ 1 0 9 °C であり、場合によっては中間層 (B) とヒートシール層 (C) の間に剥離層 (D) を有するカバーフィルム、並びに該カバーフィルムを、熱可塑性樹脂製のキャリアテープの蓋材として用いた電子部品包装体が開示される。



WO 2012/169387 A1



---

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))